

Pelnox®

产品名称	ZC-206
产品分类	单个半导体 单组份树脂
主要用途	半导体模组 一般模组
主要功能	单组份 低应力 固化收缩小 低翘曲 耐冷热冲击

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ZC-206
外观	目测	—	黑色膏状
比重	25℃	—	2.00
粘度	25℃	mPa·s	82,000

标准固化条件 150℃-1小时 + 150℃-1小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	97
玻璃化温度	TMA法	℃	146
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁶ /℃	9.9
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	4.2
弯曲强度	JIS K-6911	MPa	180
弯曲模量	JIS K-6911	MPa	18,000
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω·cm	10 ¹⁶ 以上
吸水率	JIS K 6911 煮沸2小时	wt%	0.04
	85℃85% 168小时	wt%	0.25
	PCT(121℃-100%) 100小时	wt%	0.52

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022